



SPRS TECHNOLOGIES

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能,低温漂,大功率
- 陶瓷基板,共面波导50Ω输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块

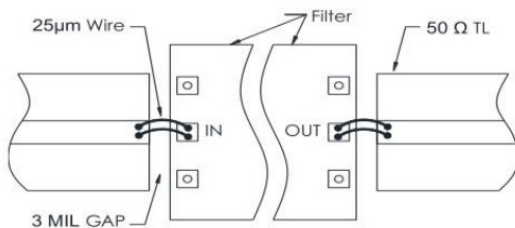
技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.5		GHz
工作频率	6.0		15.0	GHz
中心损耗		0.7	1.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		
带外抑制	@DC-4.0GHz	38	43	dBc
	@17.2-25.0GHz	10	15	dBc

环境要求

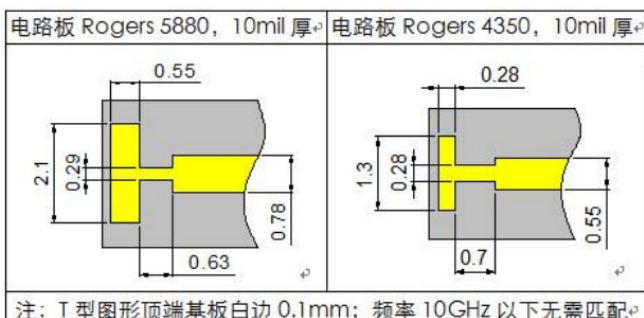
最大输入功率	25	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

推荐装配图



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可代(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配,T型尺寸如下:

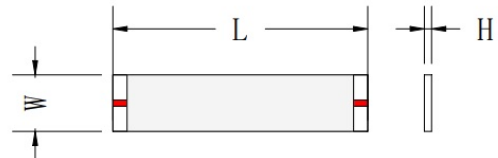


注: T型图形顶端基板白边0.1mm; 频率10GHz以下无需匹配

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

Thin Film Planar Filters

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	3.5	0.254	mm

典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$

